



第六届中国系统级封装大会

SiP Conference China 2022

日期: 2022年9月15-16日
 地点: 深圳会展中心 (福田)
 主办单位: 博闻创意会展 (深圳) 有限公司
 协办单位: 深圳市半导体行业协会、SIEM深圳先进研究院材料所、珠海市半导体行业协会
 战略合作: 芯思想

大会主席 General Chair	Nozad Karim
执行主席 Executive Chair	
技术主席及分会主席 Technical Chairs & Session Leaders	

First Day Sep. 15th	上午	会议室 (A+B) Conference Room (A+B)		
		分论坛1: 主题演讲 主席: 芯和半导体 创始人 CEO 凌峰 Session 1: Keynote Chair: Feng Ling, Founder and CEO, Xpeedic Co., Ltd		
	09:00 - 09:50	签到及入场 Registration and Networking		
	09:50 - 10:00	中国半导体行业协会封装分会 秘书长 徐冬梅 致辞 Dongmei Xu, Secretary General, China Semiconductor Industry Association Packaging Branch		
	10:00 - 10:30	晶圆厂系统级封装新代工模式 中芯国际集成电路制造有限公司 中芯国际副总裁 阎大勇 New Foundry Model for System-level Packaging in Foundries Rex Yan, VP of SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation		
	10:30 - 11:00	长电 JCET		
	11:00 - 11:30	Marketing & SiP Roadmap System Plus/ Yole		
	11:30 - 12:00	安靠 Amkor		
	12:00 - 14:00	午休及展区参观 Lunch Break & SiP Zone		
	下午	会议室 (A) Conference Room (A)		会议室 (B) Conference Room (B)
		分论坛2: SiP组装与测试 分会主席: 深圳先进电子材料国际创新研究院 院长 孙蓉 Session 2: SiP Assembly & Test I Session Leader: Prof. Sun Rong, Dean of Shenzhen Institute of Advanced Electronic Materials		分论坛3: SiP异构集成 分会主席: 芯和半导体 联合创始人、高级副总裁 代文亮 Session 3: SiP Heterogeneous Integration Session Leader: Wenliang Dai, Co Founder, SVP, Xpeedic
		14:00 - 14:30	日月光/环旭 ASE/USI	Chiplet先进封装 通富微电子股份有限公司 Chiplet Advanced Packaging TongFu Microelectronic Co.Ltd
		14:30 - 15:00	封装系统集成: 机遇与挑战 通富微电子股份有限公司 Package System Integration: Opportunity and Challenge TongFu Microelectronic Co.Ltd	深圳市奇普乐芯片技术有限公司 Shenzhen Chipuller Chip Technology Co.,LTD
		15:00 - 15:30	厦门云天半导体科技有限公司 Sky Semiconductor	Herogeneous Integration Design Flow BroadPak
15:30 - 16:00		天芯互联科技有限公司 Sky Chip Interconnection Technology Co., Ltd.	芯动科技/比特大陆 Inno Silicon OR Bitmain	
16:00 - 16:30		深圳市凯意科技有限公司 SHENZHEN KANA TECHNOLOGY CO.,LTD	面向客制化封装的增材制造技术 香港科技大学 (广州) 讲座教授 李世玮 Additive Manufacturing Technologies for Custom-made Electronic Packaging Ricky Lee, Chair Professor, HKUST(GZ)	

日期: 2022年9月15-16日
 地点: 深圳会展中心 (福田)
 主办单位: 博闻创意会展 (深圳) 有限公司
 协办单位: 深圳市半导体行业协会、SIEM深圳先进研究院材料所、珠海市半导体行业协会
 战略合作: 芯思想

大会主席 General Chair	Nozad Karim
执行主席 Executive Chair	
技术主席及分会主席 Technical Chairs & Session Leaders	

		会议室 (A)	会议室 (B)	会议室 (C)
Second Day Sep. 16th	上午	分论坛4: 先进的SiP材料和互连技术 分会主席: 香港科技大学(广州) 讲座教授 李世玮 Session 4: Advancement in SiP Material and Interconnect Technology Session Leader: Ricky Lee, Chair Professor, HKUST(GZ)	分论坛5: SiP测试与设计解决方案 分会主席: 奥特斯 李红宇 Session 5: SiP Design Solutions Session Leader: (Lio Li, AT&S)	分论坛6: SiP测试 分会主席: Session 6: SiP Test Session Leader: ()
	09:30 - 10:00	签到及入场 Registration and Networking		
	10:00 - 10:30	深圳先进电子材料国际创新研究院 院长 孙睿 Prof. Sun Rong, Dean of Shenzhen Institute of Advanced Electronic Materials	Ansys	上海恩艾仪器有限公司 NI
	10:30 - 11:00	贺利氏 Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd	西门子 Siemens-Mentor	是德科技 Keysight
	11:00 - 11:30	镭泰 Indium	Chiplet技术与设计挑战 芯和半导体科技(上海)有限公司 联合创始人、高级副总裁 代文亮 Chiplet Technology and Design Challenges Wenliang Dai, Co Founder, SVP, Xpedic	泰瑞达 Teradyne
	11:30 - 12:00	杜邦 DuPont	图研 Zuken	
	12:00 - 14:00	午休及展区参观		
	下午	分论坛7: SiP组装与测试 (2) 分会主席: 苏州晶方半导体科技股份有限公司 副总经理 刘宏钧 Session 7: SiP Assembly & Test II Session Leader: Russell Liu, VP, CHINA WAFER LEVEL CSP CO. LTD	分论坛8: SiP设备组装技术 分会主席: Session 8: SiP Substrate & Assembly Equipment Session Leader: ()	分论坛9: 分会主席: Session 9: Session Leader: ()
	14:00 - 14:30	越摩 OVM	奥特斯 AT&S	埃莎 ERSA Equipment
	14:30 - 15:00	洁创 Zestron	后摩尔时代的封装基板发展趋势 深南电路股份有限公司 技术总监 陆然 Development trend of packaging substrate in post Moore Era Lucas Lu, Technology director, Shennan Circuits Co., Ltd.	先进封装制程发展压膜及气泡解决方案 南京屹立芯创半导体科技有限公司 Advanced Packaging Process Development Lamination and Bubble Solutions Elead Technology Co., Ltd.
	15:00 - 15:30	晶方半导体 WLCSP	越亚 ACCESS	
	15:30 - 16:00	闻泰科技 Wingtech	SiP高端SMT整线解决方案 先进装配系统有限公司 华南产品市场部经理 储院生 High-End SMT total line solution for SiP Yuansheng Chu, Regional Manager Product Marketing, South, ASMPT SMT China Ltd.	
16:00 - 16:30	华天科技 Huatian Technology	腾盛 Tensun		

注: 主办机构保留变更日程的权力; 最终的日程以活动当天发布的为准。